

## 株式会社アドバンテスト

### 2026年3月期(2025年度)第1四半期決算説明会 質疑応答要旨

2025年7月29日(火)

#### [CY2025 テスタ市場規模見通し]

Q1: 今回、CY(暦年)2025のSoC テスタ TAM(市場規模)見通しを、中央値ベースで45億ドルから60億ドルへと30%以上引き上げられたが、半導体の数量増加とテスト時間増加がそれぞれどの程度寄与しているのか。

A1: 半導体の数量やテスト項目について話す前に、まずその前提についてご説明したい。今年1月と4月にTAMを開示した際に、当社を取り巻く環境は、関税政策に関する議論をはじめ、不確実性がとても高い状況にあった。多くの企業が通期業績ガイダンス開示を見送る中、当社は不確実性を認識しつつも、可能な限りの見通しを提示した。今回、SoC テスタのTAMを約30%引き上げた要因の一部は、今年1月や4月に出した予想が慎重な見積りであったことによる影響と考えている。

半導体の数量やテスト項目については、どちらかといえば数量の増加が主因と見ている。これは、今年の上期にウェーハ投入や先端パッケージングのキャパシティ調整を受けて、当初想定していなかったより多くの需要が発生し、当社が迅速に供給できたことが背景にある。

Q2: SoC テスタのTAMの引上げ幅に比べ、御社のSoC テスタ売上予想の上方修正幅は約20%に留まる。このギャップが生じた要因は何か。

A2: 当社の売上予想はFY(年度)ベースである一方、TAMはCYベースで算出されており、両者の期間差によるギャップが生じやすいという課題がある。第3期中期経営計画では、当社の全体市場シェアのKPIを58%超と設定しているが、SoC テスタはこの水準を上回るペースで推移しており、メモリ・テスタにおいても同様に高いシェアを維持している。また、TAMは米ドルベースであり、当社の売上は円ベースであるため為替変動の影響も加わり、さらなる混乱を招く要因となっている。

#### [市場シェア/競争環境]

Q3: 今回、SoC テスタのTAMと売上の予想を引き上げたが、市場シェア予想は大きな変動がないという前提でよいか。また、SoC テスタ事業における競争環境について、GPUおよびカスタムASIC向けテスタ分野で、御社の米国競合他社との競争状況はどうか。

A3: 全体的に見て、SoC テスタにおける当社のシェアは上昇傾向にある。一方、メモリ・テスタのシェアは比較的安定して推移している。

現在、当社はとても良好な市場ポジションを確保しており、今後もこのポジションを維持できると考えている。顧客の製品の立ち上げ期において、顧客がテストプラットフォームを

切り替えることは非常に難しい。当社は GPU およびカスタム ASIC 向けテスト分野において、将来にわたり極めて強固なポジションおよび競争力を有していると認識している。

[FY2025 Q1 実績]

Q4: FY2025 Q1 業績が上振れた要因を教えてください。例えば、関税政策の影響があったか。あるいは、何かしらの特需の影響か。

A4: 売上の面では、多くの前倒し需要が発生した。当初はこれほど大きな四半期売上になるとは想定しておらず、需要はより平準化されると見込んでいた。しかしながら、実際には大幅な前倒し需要があり、加えて需要自体も当初の想定を上回る水準となった。利益の面で、Q1 は非常に好調だった。製品ミックスが良好であったことに加え、スケールメリットや業務効率の向上も奏功し、さらに減損などの一時的な損失も発生しなかった。これら全てが好業績につながった要因。

Q5: FY2025 Q2 以降の業績見通しについて。Q1 の好業績の持続性はどの程度か。また、同下期の予想が上振れる可能性はないか。

A5: Q1 の好業績の要因の中には持続可能なものと、そうでないものがある。持続可能な要素として製品ミックスがあり、今後若干の変動はあるものの、引き続き SoC テスタがメモリ・テスタより高い構成比を維持する見込みである。また、当社が推進している業務効率化の一部は今後も継続して効果を発揮すると見込んでいる。ただし、FY2025 Q1 の業績は、さまざまな要素がとても良い形で重なった特別な四半期であり、今後も同様の規模の四半期が継続するとは申し上げられない。それを前提として見通しを立てることは適切ではないと考えている。

FY2025 の Q3、Q4 を見通すと、前倒し需要の影響が、一部売上の減少として表れてくると考えている。また、現在は多くのデバイスが世代移行期にあり、AI アクセラレータ市場では、汎用 GPU とカスタム ASIC の両方が立ち上がりつつある。加えて、メモリ分野では HBM(High Bandwidth Memory)の世代交代も進んでおり、これら新しいデバイス群に向けた投資が活発化している。これらの成果は、FY2026 に本格的に顕在化してくる見通し。

Q6: FY2025 Q1 の SoC テスタ売上について、GPU 向けとカスタム ASIC 別の売上比率を教えてください。

A6: 顧客固有の情報を含むため、内訳の開示は差し控えさせていただきます。現時点では、依然として従来型 GPU 向けが大部分を占めているが、カスタム ASIC の比率も現在増加傾向にあり、CY2026 にはより大きな割合を占めると見込んでいる。

[FY2025 通期見通し]

- Q7: FY2025 2H に調整局面を迎えるとのことだが、FY2025 Q2 以降の四半期業績推移をどう予想しているか。
- A7: FY2025 Q1 は非常に好調な四半期となった一方、Q3 は通期の中で最も低調な水準になると見込んでいる。Q4 には売上が回復し、その成長は FY2026 にかけて継続する可能性が高いと考えている。

[FY2026 以降の見通し]

- Q8: 今年 4 月の決算説明会で、ダグラスさんは CY2026 に対して明るい見通しを示していた。現時点で FY2026 の見通しはどうか。FY2025 に比べて売上増加を見込むことができるか。
- A8: 当社は FY2026 をとても楽観的に見ている。ウェーハ生産能力および先端パッケージングの増強が、半導体の数量およびテスト・キャパシティの需要をさらに押し上げると見込んでいる。また、ハイパースケーラーによる設備投資も堅調に推移しており、これはとても心強い要素だ。
- 半導体の複雑性がより一層と増す中で、テスト項目の増加も求められている。さらに、民生品および自動車用デバイス向けなどのテスト需要回復にも期待を寄せている。これらを踏まえると、現時点で、FY2026 に需要が減速する理由は見当たらない。今後、視界がより明確になれば、より詳細な見通しを示していく。

- Q9: CY2026 に向けたとても前向きな見通しを示されているが、CY2027 について、業界の動向を踏まえてどのように捉えているか。
- A9: CY2026 から CY2027 にかけての見通しについて、顧客によるウェーハ投入数の増加や先端パッケージング能力の拡充、さらにはハイパースケーラーの設備投資予算といった要素を注視している。これらの分野においては、現在のトレンドが継続するとの見方が業界内でも広く共有されており、仮にその傾向が続けば、CY2026 を超えて CY2027 にかけても成長サイクルが継続するとの期待が持てる。
- もともと、当社は過去の経験から、サイクルの変動が急速に起こり得ることを十分に認識しており、そうした前提に立って慎重かつ柔軟に事業運営を行っている。

[生産能力の増強]

- Q10: 「FY2024 比で 70%以上の生産能力拡大」ということだが、この目標の時間軸はどうか。また、SoC テスタの生産能力拡大について、ベースラインの定義を確認させてほしい。
- A10: 当社は現在、すべての顧客ニーズに対応可能な生産能力を備えている。過去数年間で生産能力を約 3 倍に拡大してきた。次のキャパシティ増強のステップは、SoC テスタ・プラットフォームおよびメモリ・テスタ・プラットフォームで、CY2026 末を目標に実施する計画

だ。SoC テスタでは、CY2025 を基準として 60~70%の拡張を見込んでいる。これは単に次の需要に対応するためだけではなく、予測を超える需要の変動に備えるためでもある。AI 関連の需要急増は顧客にとっても予測が難しく、当社としても迅速に対応するためには、一定のバッファを持ったキャパシティの確保が不可欠であると考えている。なお、ベースラインについて、具体的な数値への言及は控えるが、当社の V93K プラットフォームについては、現時点で年間 3,000 台以上の出荷が可能である。

- Q11: 今回の生産能力増強への取組みは恒久的なものか。それとも、より一時的な対応か。  
A11: 半導体業界が長期的に 1 兆米ドル規模の市場へと成長すると見込まれている中、当社は今回の生産能力増強は恒久的な対応として位置づけている。一時的な措置ではない。さらに長期的には、追加のキャパシティ拡張が必要になる可能性が高く、すでにそのための計画も一部着手している。

#### [ダイレベルテスト]

- Q12: AI 需要が増える以前は、テスタ需要はウェーハ用とファイナルテスト用でほぼ同等の比率だったと理解している。しかし、チップレット構造の採用が進み、数量が増加する中、ウェーハ用とファイナルテスト用の需要比率について、現在の傾向や見解を教えてください。また、Q4 以降の継続的な成長はウェーハ用テスタ需要の増加によるものか。加えて、御社のダイレベルテスト向け需要にも変化があるかについても教えてください。  
A12: チップレット戦略の進展に伴い、パッケージのコストが高騰していることから、KGD(Known Good Die)\*の価値が一層高まっており、ウェーハ用テストの重要性が増している。当該分野のビジネスは、ファイナルテストより速いペースで成長すると予測されており、ダイレベルテストは、新たな成長機会として注目されている。

シリコンレベルでの KGD テストに重点が置かれることで、新たなソリューションの導入が求められる。特に、単一のウェーハでは実現が困難な、ダイまたは部分組立レベルでの熱制御機能が重要となる。ウェーハおよびダイレベルでのテストフローの進化により、新たなテスト工程が生まれる可能性があり、これらはすべて大きな成長機会と捉えている。

\*Known Good Die (KGD): 品質を保証された良品のベア・ダイ

#### [メモリ・テスタ事業]

- Q13: 今後の HBM 向けメモリ・テスタ需要は、デバイスのビット数の増加が需要を牽引するのか。もしくは次世代 HBM への移行が牽引するのか。  
A13: 当社はメモリ・テスタ事業について楽観的な見通しを持っており、その背景には複数の要因がある。中でも、HBM(High Bandwidth Memory)は主要な成長ドライバーとして位置付けており、HBM4 や HBM4E への世代移行、より多層な HBM への需要の高まりが、今後のテスタ需要拡大を牽引すると見込んでいる。HBM の成長に加え、当社は非常に良好

な製品構成と市場における優位性を維持しており、特に DRAM 分野においては圧倒的な競争力を有している。これらの要素が、メモリ・テスト事業に対する当社の強い自信を支える根拠となっている。AI 需要の継続的な拡大やデータセンターの増設が進む中で、メモリ・デバイス需要も今後さらに増加することが見込まれる。これにより、デバイスの出荷数量も増加し、当該分野における良い成長機会になると考えている。

#### [近縁市場]

Q14: 近縁市場の成長について。サービスを含めて、どの分野での成長を見込んでいるのか。

A14: 当社の成長見通しを支える要素はいくつかある。まず、システムレベルテスト(SLT)は、プロセスノードの微細化とテスト需要の増加に伴い、大きな成長機会を有している。当社はこの分野に対して継続的に積極的な投資を行っており、今後の事業拡大を強く期待している。

また、デバイスインターフェース(DI)事業も有望であり、戦略的な投資の成果と、ターンキー・アプリケーションに対する顧客ニーズの高まりが、成長を後押ししている。さらに、エンジニアリング・サービスおよびワランティ・サポートについては、設置台数の増加に伴った成長が見られ、当社の業績にもその成果が反映されている。

加えて、顧客からはより高度な機能やサービスへの期待が高まっており、これまで対応していなかった新たなサービス分野においても、成長の機会が生まれつつある。これらの取り組みは現在開発段階にあるが、将来的には当社の業績に対して有意義な貢献をもたらすものと見込んでいる。

#### [報告セグメント変更]

Q15: テストハンドラとシステムレベルテストを「Test System Business」セグメントに組み入れた理由は？

A15: メカトロニクス・システムとしていた従来の報告セグメントは、現在の事業環境に照らすとやや旧式な枠組みとなっていた。そこで、当社は報告セグメントを簡素化し、テストシステム事業と、サービス他事業に再編することで、業界内の多くの企業が採用している構成により近づけることとした。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。法令により義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、将来予想に関する記述を更新または修正することはありません。